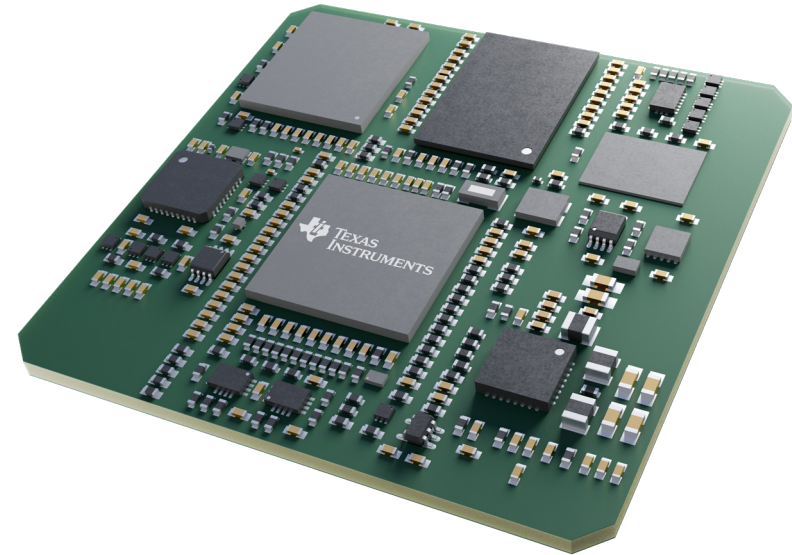


# Embedded Module mit TI AM62

Open Standard Module™ - iesy AM62 OSM-LF

## Technisches Konzept

- ▶ Prozessor: AM6231 Single-Core A53 (no 3D GPU) + Cortex-M4F MCU
- ▶ Taktrate: 800 MHz (A53) / 400 MHz (M4F)
- ▶ Arbeitsspeicher: 512 MByte LPDDR4
- ▶ Flash Speicher: 8 GByte e-MMC 5.1
- ▶ Abmessung: 45 mm x 45 mm
- ▶ Footprint: OSM Size-L  
Land Grid Array (LGA) mit 662 Kontaktpunkten
- ▶ Temperaturbereich: 0 °C bis +85 °C
- ▶ Spannungsversorgung: Single Supply 5VDC
- ▶ Funktionen & Schnittstellen
  - > 2x Ethernet 1 GBit (RGMI)
  - > 1x USB 2.0 (Client/Host/OTG)
  - > 1x MIPI CSI (4 Lanes, I2C)
  - > 1x RGB (18bit) - optional
  - > 1x Dual-LVDS (I2C)
  - > 1x SD-Card + 1x SDIO (4bit)
  - > 37x GPIO (incl. PRU-Signals)
  - > 2x CAN
  - > 1x I2S
  - > 2x I2C
  - > 1x Quad-SPI + 2x SPI
  - > 3x UART + 1x Debug-UART



## Über OSM™

Die Open Standard Module™ Spezifikation wurde 2019 von der SGeT e.V. verabschiedet. Der neue Standard wurde entwickelt, um zukünftigen Anforderungen in Bezug auf **Flexibilität**, **Skalierbarkeit**, aber auch der **Kostenreduktion** gerecht zu werden. OSM™-Auflötmodule können individuell an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst werden. Dazu können die einzelnen Module mittels Tray & Reel im **SMT-Prozess** automatisch verarbeitet werden. Die OSM™ Serie umfasst insgesamt vier verschiedene Formfaktoren.



[iesy.com/osm](https://iesy.com/osm)